

芯导科技专注功率半导体领域

上交所日前受理了芯导科技科创板上市申请。公司此次拟募资4.44亿元,投向高性能分立功率器件开发和升级等项目。

●本报记者 刘杨

采用Fabless经营模式

招股书申报稿显示,芯导科技主营业务为功率半导体的研发与销售。公司的专利和核心技术均用于主营业务,覆盖功率器件和功率IC产品应用的消费电子、网络通信、安防、工业等领域。公司的核心产品已通过小米、TCL科技、传音等客户的验证。

芯导科技采用Fabless经营模式,专注于功率半导体相关产品的芯片设计、晶圆制造和封装测试环节委托给专业的生产厂商。公司将研发设计的技术文件提供给晶圆厂商,由其加工定制晶圆后,再由封装测试厂商提供封测服务。

公司建立了稳定的晶圆制造、封装测试供应链道,与主要外协供应商形成了较为稳定的合作关系。公司具有完善、严格的外协供应商管理体系,对主要晶圆制造厂家及封测厂家进行有效管理,以保证产品供应长期稳定,质量

主营业务收入存季节性波动

报告期内,芯导科技分别实现营业收入29375.17万元、27962.99万元及36835.41万元;扣非净利润分别为5158.04万元、4539.03万元及7160.35万元。综合毛利率分别为28.20%、29.17%和32.07%,主要在于公司产品结构优化、供应链管理等变化所致。

公司表示,随着功率半导体产品应用领域不断拓展和深入,以及行业竞争格局的变化,下游市场存在波动的可能性。公司的核心技术优势、持续创新能力、供应链管理水平以及新产品升级迭代周期等因素都可能影响公司毛利率水平。如果上述因素发生重大变化,公司产品毛利率将面临波动的风险。

招股书显示,公司存货主要由原材料、委托加工物资和库存商品构成。报告期各期末,存货账面价值分别为2503.44万元、2514.10万元和3329.10万元,存货跌价准备余额分别为118.88万元、240.60万元和229.83万元。

拟募资投向科技创新领域

芯导科技本次募集资金投资项目均属于科技创新领域,包括高性能分立功率器件开发和升级、高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化、硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目及研发中心建设项目等。

公告显示,高性能分立功率器件开发和升级及高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目,将进一步补充和提升公司主营业务;硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目可以满足未来第三代半导体材料应用导致的对功率器件性能提升的需求;通过研发中心建设项目,公司将进一步引进功率半导体领域的优秀人才,购置先进的研发及实验设备,对公司现有核心技术、主